

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

**江苏艾森半导体材料股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

编号：2026-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	线上参与公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 4 月 30 日 10:00-11:00
地点	网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长：张兵 常务副总经理兼董事会秘书：陈小华 财务总监：吕敏 独立董事：李挺
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：公司属于小而美的公司，很多细分电子材料都有突破，但是感觉每一块的营收规模都不太大，市场需求天花板也不高，公司有没有打算打造一款核心产品，作为公司的拳头产品，而且也有比较好的市场需求规模。另外，公司投资扩产周期是在太长了，公司这两年营收规模增长也比较缓慢，建议公司积极考虑产业链或者行业并购。</p> <p>答：尊敬的投资者您好：一、关于打造核心拳头产品</p> <p>公司以封装用电镀液及配套试剂为切入点，紧跟半导体工艺演进及市场需求，逐步研发出可应用于先进封装的光刻胶系列产品，并成功将电镀</p>

液产品拓展至 28nm 以下制程的晶圆制造先进领域。目前，公司产品矩阵日益丰富，市场空间持续打开，市场地位也更为明确。其中，2025 年光刻胶及配套试剂业务收入同比增长 43.54%，光刻胶收入达 3,030.72 万元；晶圆制造材料方面，大马士革镀铜添加剂、钴制程电镀液等产品实现量产突破，核心产品已形成差异化竞争优势。随着芯片堆叠工艺带来的超线性增长需求以及我国先进制程的快速发展，公司产品对标市场潜力巨大，并非局限于较小的天花板。公司正重点聚焦光刻胶和先进电镀液两大方向，持续打造具备大规模市场需求的拳头产品。

## 二、关于扩产周期与并购建议

半导体材料行业的产能建设具有技术验证周期长、客户认证要求高等特点，扩产周期较长属于行业共性。为更高效满足未来市场需求，公司已规划多元化的产能提升路径：通过改扩建现有产线、灵活增加中试基地、以及新建华东制造基地等项目，构建安全、有竞争力的产能体系，努力缩短扩产响应周期。

关于并购，公司将结合技术互补和产业链协同等因素，审慎评估合适的并购机会。目前阶段，公司优先通过内生增长巩固细分领域优势，同时保持对产业链及行业并购的开放性，未来在条件成熟时不排除通过适当并购加速发展。

再次感谢您对公司发展的关心与宝贵建议。

**问题二：请问贵司用于 RDL 介质的负性 PSPI 进展如何，是否有在手订单**

答：公司自研适用于先进封装领域的低温 PSPI，近期已拿到客户的订单，作为 RDL 绝缘层，可应用于扇外型晶圆级封装、2.5D/3D 封装等。

**问题三：经营现金流净额由负转正，改善核心原因是什么，能否持续保持？**

答：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比改善，主要系增加对供应商票据付款、收到的票据中提升高信用等级承兑银行汇票比例，提高资金管理效率；同时销售商品，提供劳务收到的现金增长幅度大于本期购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度。

**问题四：请问公司在市值管理方面做了哪些工作？**

答:公司市值受二级市场、行业发展趋势以及公司经营业绩等多重因素的影响。公司注重产品研发和业务技术的突破,持续高研发投入,从而实现业绩的稳步增长。公司采取现金分红、资本公积转增股本、回购公司股份、实施员工股权激励,用于维护公司价值及股东权益,推动公司内在价值提升。另外公司建立了包括信息披露、e 互动、业绩说明会、路演、反路演、组织中小投资者调研等多渠道沟通体系,持续加强与广大投资者的沟通交流,有效传递公司价值。

**问题五:公司先进封装材料今年销量增长怎么样?**

答:公司在先进封装材料领域呈现显著增长态势。2025 年光刻胶及配套试剂业务收入同比增长 43.54%,主要的增量来自于先进封装领域。

随着 AI 芯片、HBM(高带宽存储)及 CPO(光互联)市场的扩张,先进封装对光刻胶及配套试剂的需求从线性增长转向超线性扩张。公司在先进封装光刻胶及电镀液领域深耕多年,已构建起从核心材料研发、配方优化到工艺量产的全链条成熟体系,技术储备与产业化能力处于行业前列。通过持续研发投入,公司已形成覆盖先进封装全部工艺环节的产品矩阵,产品关键性能指标已达到国际同类产品水平,可充分匹配下游先进封装技术路线的应用需求。

公司募投的“集成电路材料华东制造基地一期项目”将扩大先进封装材料产能,匹配 2.5D/3D 封装、Chiplet 等技术需求,加速市场份额提升。

**问题六:2026 年营收与利润增长目标**

答:公司始终坚持以稳健经营为核心原则,将重点聚焦于提升自身核心竞争力上。在业务层面,我们将持续推进产品结构优化,加大在高附加值产品领域的研发投入,通过技术创新提升产品的市场竞争力和公司盈利能力。

**问题七:电镀液与光刻胶业务均高速增长,两大板块产能利用率与产销匹配情况如何?**

答:目前公司现有产能 16,000 吨,可支撑核心产品的规模化供应,产品覆盖晶圆制造、先进封装及显示面板等领域,其中电镀液已实现先进制程突破,光刻胶产品矩阵覆盖十余款型号。产能利用率处于高位。

	<p>公司始终以市场需求为核心动态调整产能与产销匹配：一方面，针对高景气的高端产品领域，我们通过产能优化、设备升级等方式保障供应；另一方面，公司也在持续推进精细化管理，确保资源高效利用。</p> <p><b>问题八：想问一下公司去年研发投入主要在哪些项目？今年是否会继续加大研发投入？有怎样的研发计划及预期？</b></p> <p>答：2025年，公司围绕下游产业升级需求，聚焦核心技术攻坚与产品矩阵拓展，公司研发投入在光刻胶技术升级，如KrF光刻胶、PSPI光刻胶等高端产品的研发；先进封装及晶圆制造材料的国产化替代，如TSV镀铜添加剂、先进制程超纯电镀液等。</p> <p>公司会继续坚持以市场需求为导向，加大研发投入，结合行业技术发展趋势，合理配置研发资源。一方面，持续深化在成熟业务领域的技术优化，提升产品性能与性价比，进一步夯实与核心客户的合作粘性；另一方面，也会积极探索前沿技术方向布局产品研发，提前卡位市场机会。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年5月7日</p>